

证券代码：300672

证券简称：国科微

湖南国科微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	民生电子 方竞、李萌；博时基金 符昌铨；百年资管 蒋捷；南土资产 王可；创富兆业 刘姝仪；理成资产 王元廷；华能贵诚信托 孙宇；五地基金 王帅、张骏亚（排名不分先后）。
时间	2025年11月19日 15:00-17:00
地点	湖南省长沙市长沙县榔梨街道东四路南段128号国科集成电路产业园9#栋2楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：向平先生 董事会秘书：黄然先生 证券事务代表：叶展先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、陪同投资者参观公司展厅，介绍公司基本情况、业务布局、产品研发等情况。 二、问答环节 1、公司与鸿蒙生态合作有何进展？ 答：尊敬的投资者，您好。截至目前，公司旗下8款开源鸿蒙芯片平台实现在智慧家庭、智慧视觉、智慧大屏以及商业显示等行业的量产商用。在智慧家庭与教育领域，基于GK6323V100C的社区共建硬件平台已落地多个标杆项目，支持超50款原生鸿蒙应用。该芯片入选鸿蒙生态星火实验室首款开发平台，借助鸿蒙系统组件化部署实现极低内存占用，正进行更多智能家居产品开发。

在智慧视觉领域，公司将超低功耗 AOV 方案及 30 余种音视频 AI 算法全面移植至 OpenHarmony 5.1 系统中，基于鸿蒙系统组件化与低延时设计，实现媒体通路延时降低 20%。当前，公司正与中国移动基于开源鸿蒙智慧视觉芯片平台合作开发太阳能摄像机、宠物陪伴机器人等。

在智慧大屏领域，公司针对 OpenHarmony4.0 版本在大屏场景的系统级支持不足问题，完善视频通话、网络共享等 30 项核心功能，优化低延时白板、UI 快速响应等 12 项关键性能指标，使终端使用体验比肩安卓系统，并首次在开源鸿蒙平台实现对全国产音视频标准的支持，为教育会议等场景提供全栈安全解决方案。

在商业显示领域，依托鸿蒙软总线技术构建的分布式显示系统，基于公司芯片开发的数字标牌主板可实现多屏内容同步、跨屏控制等功能，已落地商场导视屏、户外广告机等产品。

未来，公司将持续加码开源鸿蒙生态建设，与产业链伙伴携手推动开源鸿蒙生态澎湃向前。感谢您对公司的关注。

2、公司在固态存储领域有哪些优势？

答：尊敬的投资者，您好。公司在固态存储领域深耕多年，从成立之初就扛起国产化大旗，从上游供应商、到自身内部技术体系、再到客户产品适配等方面，都深耕国产化技术体系。经过多年的积累，形成了领先行业的国产化存储技术与完整的国产化存储技术体系。公司在固态存储领域已完成“固态硬盘控制芯片+行业固态硬盘产品”双业务引擎的商业模式布局，致力于通过持续研发积累打造自主安全可控的存储生态体系。公司自研的固态存储主控芯片搭载国产嵌入式 CPU IP 核，已通过国密国测双认证及自主原创认证，可实现全国产供应链交付。

公司将继续利用现有技术优势，深耕国产化技术体系，进一步开拓国产替代市场。感谢您对公司的关注。

3、公司目前有哪些在研算力芯片？

答：尊敬的投资者，您好。公司围绕“ALL IN AI”战略，基于自研先进 MLPU 技术，持续聚焦人工智能边缘计算 AI SoC 研发，基于大模型+SoC 赋能智能终端大模型应用。公司人工智能 AI SoC 系列产品包括

8TOPS 小算力 AIoT 终端芯片、16TOPS 边缘计算芯片，以及预研的 64TOPS~128TOPS 大算力芯片，形成 AI 算力低中高的 AI SoC 产品布局，主要应用于 AIoT 智能终端、AIPC、工业计算、机器人（含具身智能）等场景应用。

在 AI 视觉方面，公司推出了新一代 AI 图像处理引擎（AI ISP）品牌——圆鸮。依托圆鸮 AI ISP 技术底座，公司已成功打造两款差异化 4K AI 视觉芯片矩阵——面向高端市场的 GK7606V1 系列与聚焦普惠应用的 GK7206V1 系列。

目前，GK7606V1 系列已在安防行业头部企业实现应用，该产品采用双核 A55 架构，内置最高 2.5T 算力 NPU；GK7206V1 系列已量产上市，成功进入传统安防与消费类电子头部企业供应链体系，该系列芯片采用低功耗设计，集成 1.0T@INT8 NPU。经前期用户反馈，GK7206V1 系列黑光全彩效果出众，在同类产品中处于领先水平。

GK7206V1 将与 GK7606V1 系列形成“高端-普惠”双线产品布局，已落地智能安防、车载记录仪、无人机图传、运动摄像机及智能会议系统等多元场景，为行业提供全场景 AI 视觉解决方案。

在 AI 芯片架构方面，公司实现突破性创新，其首创的面向多模态大模型的 MLPU 芯片架构，既能高效支撑大模型推理计算，又可兼容传统小模型的高效处理需求。基于这一架构，公司已规划形成覆盖多款智能终端的 AI SoC 产品矩阵，未来将广泛应用于机器人、AI PC、无人机、工业计算等智能终端场景。

未来，公司将持续深化“芯片+算法+生态”的三维驱动模式，通过 AI 技术深度赋能产品升级，以扎实的技术实力巩固品牌根基，并通过与客户及合作伙伴的紧密协同，共同创造价值。感谢您对公司的关注。

4、公司在车载电子领域的产品规划？

答：公司在车载 AI 芯片和 SerDes 芯片领域持续投入研发。

公司推出的车载 AI 系列芯片主要应用在前装智能摄像头、行车记录仪、流媒体电子后视镜、电子外后视镜、摄像头监控系统、驾驶员疲劳监测系统、座舱监控系统、前视 ADAS 一体机等产品上，公司 2025 年上

	<p>半年推出新一代满足 AEC-Q100 Grade2 的车载 AI 芯片已回片并点亮，AEC-Q100 的相关验证正在进行中，目前在积极推广。公司将持续研发新的产品，计划三年内形成 200 万至 800 万、算力从低到高的全系列车载 AI 芯片。</p> <p>同时，公司推出的串行解串（SerDes）芯片在前装车载业务领域，主要应用于智能座舱和智能驾驶的摄像头端和显示屏端的数据传输。公司在 2024 年已推出多颗 4.2Gbps 和 6.4Gbps 芯片，覆盖摄像头和显示屏业务，技术指标优秀，满足车载场景要求。</p> <p>5、公司的 Wi-Fi 产品研发进展以及产品规划？</p> <p>答：公司 Wi-Fi 业务归属于物联网业务板块，2025 年上半年，公司物联网系列芯片产品实现销售收入 12,814.71 万元，同比增长 251.37%，占公司 2025 年上半年营业收入的 17.28%。物联网系列芯片产品上半年整体毛利率为 41.07%，同比提升 26.93 个百分点。</p> <p>公司确定了立足中低端、积极发展中高端，并在低中高端实现无线局域网芯片的全面国产替代的策略。目前，公司开发的 Wi-Fi6 2T2R 无线网卡芯片已开发完成并完成调试，正在导入国内主流的电视和运营商的方案厂商及网卡厂商，有部分客户已经实现小批量试产。在 Wi-Fi6 2T2R 的基础上，公司的 Wi-Fi6 1T1R+蓝牙的 Combo 芯片正在进行回片调试，目前芯片功能和性能正常，有望在 2025 年 Q4 开始客户导入。另外，公司针对 IPC、行车记录仪、图传、网卡市场开发的 Wi-Fi4 1T1R 无线局域网芯片已经量产。公司将加速在无线局域网芯片领域的研发进度，并积极开展 Wi-Fi7 芯片的预研工作。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 11 月 19 日